

平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月11日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社アバールデータ
 コード番号 6918 URL <http://www.avaldata.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 管理本部部長
 四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(氏名) 嶋村 清
 (氏名) 大関 拓夫

TEL 042-732-1000

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	1,907	16.8	207	149.8	238	102.4	173	78.6
23年3月期第1四半期	1,632	138.0	83	—	117	—	96	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 136百万円 (—%) 23年3月期第1四半期 △113百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	29.09	—
23年3月期第1四半期	13.08	13.03

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	10,073	8,109	74.1
23年3月期	9,718	8,050	76.1

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 7,465百万円 23年3月期 7,396百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	8.00	—	12.00	20.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	11.00	—	13.00	24.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	3,710	7.1	350	29.8	380	23.6	255	17.9	42.84
通期	7,700	9.3	790	26.6	835	19.8	555	11.9	93.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期1Q	8,064,542 株	23年3月期	8,064,542 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	2,109,967 株	23年3月期	2,112,748 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期1Q	5,952,704 株	23年3月期1Q	7,408,245 株

(注)当社は当連結会計年度より、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しております。当該プランにかかる信託口が所有する当社株式数については、四半期連結財務諸表において24年3月期1Qの自己株式として表示していることから、当該信託口が所有する当社株式数については、24年3月期1Qの「期末自己株式数」に309,600株を含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から311,477株を控除しております。
なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの詳細については【添付資料】4ページ(3)追加情報に記載しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きを実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

添付資料の目次

1 . 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	3
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2 . サマリー情報（その他）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(3) 追加情報	4
3 . 四半期連結財務諸表等	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) セグメント情報	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
4 . 補足情報	11
(1) 生産、受注及び販売の状況	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年3月11日に発生した東日本大震災の影響による生産活動や経済活動の停滞、原子力発電所事故の長期化に伴う電力供給不足、不安定な海外経済や円高進行の影響により、依然として不透明な状況が続いております。

当社グループに関連深い半導体製造装置業界におきましては、各種デジタル機器の需要が継続し、大手ファブリー及びメモリーメーカーの大型投資が計画されるなど、半導体製造装置市場の需要は引き続き順調に推移しております。

このような経営環境のもと、当社グループは顧客満足度の更なる向上のために、市場ニーズを先取りした新製品の投入によりお客様の装置の進化に貢献するとともに、省電力の設備導入と生産性向上で環境に優しいモノ作りを実現、品質面では業界水準を越える品質の確保、さらに社内業務プロセスを見直すことにより、収益性の向上に取り組みました。

この結果、第1四半期連結累計期間における売上高は1,907百万円（前年同四半期比16.8%増）、営業利益は207百万円（前年同四半期比149.8%増）、経常利益は238百万円（前年同四半期比102.4%増）、四半期純利益は173百万円（前年同四半期比78.6%増）となりました。

当社グループでは、事業内容を2つの報告セグメントに分けております。当第1四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。

受託製品

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器及び計測機器の開発・製造・販売を行っております。半導体製造装置関連の特に前工程の順調な設備投資に加え、夏場の節電対応による前倒し出荷依頼により、売上高は増加しております。

この結果、売上高は1,328百万円（前年同四半期比12.3%増）、セグメント営業利益は220百万円（前年同四半期比50.0%増）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 半導体製造装置関連

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。大手半導体メーカーのLSI微細化が続く中、最先端の半導体製造装置への積極的な設備投資が続き、受注が順調に推移したため、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は977百万円（前年同四半期比17.9%増）となりました。

ロ) 産業用制御機器

当該品目は、各種の産業用装置、社会インフラ関連の制御部を開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。産業用装置の受注は堅調に推移しましたが、社会インフラ関連に落ち込みが見られ、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は175百万円（前年同四半期比16.6%減）となりました。

ハ) 計測機器

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部を開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。主力の電力関連機器全般の回復に加え、各種計測機器の受注が順調に推移し、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は176百万円（前年同四半期比22.6%増）となりました。

自社製品

当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュール及び計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器及びソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。自社製品全般の受注が順調に推移し、売上高は増加しております。

この結果、売上高は578百万円（前年同四半期比28.7%増）、セグメント営業利益は118百万円（前年同四半期比135.7%増）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 組込みモジュール

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。FA全般及び半導体製造装置関連の受注が順調に推移し、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は193百万円（前年同四半期比21.5%増）となりました。

ロ) 画像処理モジュール

当該品目は、FA全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。新製品の立ち上がりに加え、新分野での営業開拓が進み、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は180百万円（前年同四半期比28.8%増）となりました。

八) 計測通信機器

当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・コールセンター向けCTI (Computer Telephony Integration) 及びリモート監視機器を提供しております。CTIの大口受注が減少しましたが、超高速シリアル通信モジュールはFA全般の受注を堅調に推移したことに加え、新規顧客の受注が大幅に増大したことにより、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は160百万円 (前年同四半期比28.9%増) となりました。

二) 自社製品関連商品

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフトウェア及び付属の周辺機器を提供しております。自社製品全般が回復に転じたことにより、売上高は大幅に増加いたしました。

この結果、売上高は44百万円 (前年同四半期比70.4%増) となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産は10,073百万円 (前連結会計年度末比354百万円の増加) となりました。

流動資産につきましては、主に、現金及び預金が201百万円増加、受取手形及び売掛金が72百万円増加、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品これらのたな卸資産が70百万円増加、その他が未収入金の増加等により65百万円増加した結果、408百万円増加し6,468百万円となりました。固定資産につきましては、主に、有形固定資産7百万円増加、無形固定資産が6百万円減少、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動等の影響により55百万円減少した結果、54百万円減少し3,605百万円となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債は1,963百万円 (前連結会計年度末比295百万円の増加) となりました。

流動負債につきましては、主に、支払手形及び買掛金が221百万円増加、1年内返済予定の長期借入金34百万円増加、未払法人税等が113百万円減少、賞与引当金が18百万円減少、役員賞与引当金が9百万円減少、その他が前受金、未払費用及び預り金の増加等により46百万円増加した結果、158百万円増加し1,392百万円となりました。固定負債につきましては、主に、長期借入金166百万円増加、役員退職慰労引当金が6百万円減少、その他が繰延税金負債の減少等により24百万円減少した結果、136百万円増加し571百万円となりました。

なお、負債項目に記載しております、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」導入によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は8,109百万円 (前連結会計年度末比59百万円の増加) となりました。

主に、利益剰余金が101百万円増加、その他有価証券評価差額金が35百万円減少したことが要因となります。

(自己資本比率)

当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は74.1% (前連結会計年度比2.0ポイント減少) となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、平成23年5月13日付「平成23年3月期 決算短信」に公表いたしました業績予想及び配当予想と同様です。

なお、本資料に記載した業績予想等は、概ね計画通りに推移しており、平成23年5月13日に公表した数値からの変更はございません。

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

2. サマリー情報 (その他) に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はございません。

- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

当第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日) 及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第4号(平成22年6月30日)を適用しております。

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

なお、これによる影響は軽微であります。

(3) 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

(信託型従業員持株インセンティブ・プランの会計処理について)

当社は、平成23年5月25日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。

割当先である野村信託銀行株式会社「アパールグループ社員持株会専用信託口」(以下「信託口」といいます。)は、当社と野村信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定された信託口であります。

本プランでは、信託口が、本信託の設定後6年間にわたりアパールグループ社員持株会(以下「本持株会」といいます。)が取得すると合理的に見込まれる数の株式会社アパールデータ株式を、金融機関からの借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を株式会社横浜銀行、借入人を信託口、保証人を当社とする三者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。

信託口が取得した当社株式は、本持株会と締結される株式注文契約に基づき、信託期間(6年)において、毎月、その時々の時価で売却いたします。

本信託では、当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を借入金の返済及び金利の支払いに充当いたします。本信託の終了後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余の財産が存在する場合は、当該金銭を、本信託契約で定める受益者適格要件を満たす社員に分配いたします。なお、当社は信託口が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落等により本信託の終了時点において借入金が完済できない場合は、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき保証人である当社が保証履行いたします。

当社は平成23年6月22日付で、自己株式312,400株を信託口へ譲渡しております。当該自己株式については、当社から信託口へ株式を譲渡した時点で売却処理を行っております。また、信託口が所有する株式を含む資産及び負債ならびに費用及び収益については、当社と信託口は一体であるとし、当社の四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて処理しております。なお、信託口が所有する株式については自己株式として表示しており、当第1四半期連結累計期間末において、信託口が所有する当社株式数は、309,600株となっております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,525,982	2,727,153
受取手形及び売掛金	1,415,103	1,487,459
有価証券	10,149	10,151
商品及び製品	396,204	404,077
仕掛品	375,709	395,671
原材料及び貯蔵品	744,465	786,867
その他	591,931	657,006
流動資産合計	6,059,547	6,468,387
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,316,699	1,316,699
その他(純額)	965,591	973,387
有形固定資産合計	2,282,290	2,290,087
無形固定資産		
57,988	57,988	51,587
投資その他の資産		
投資有価証券	1,260,718	1,202,173
その他	88,730	91,780
貸倒引当金	30,533	30,503
投資その他の資産合計	1,318,915	1,263,449
固定資産合計	3,659,194	3,605,124
資産合計	9,718,742	10,073,511
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	705,624	926,656
1年内返済予定の長期借入金	-	34,000
未払法人税等	187,302	73,313
賞与引当金	162,607	143,622
役員賞与引当金	14,660	4,816
その他	163,838	209,939
流動負債合計	1,234,031	1,392,347
固定負債		
長期借入金	-	166,620
退職給付引当金	94,687	95,499
役員退職慰労引当金	77,030	70,672
その他	262,724	238,375
固定負債合計	434,442	571,167
負債合計	1,668,474	1,963,514

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,354,094	2,354,094
資本剰余金	2,456,077	2,446,534
利益剰余金	3,562,149	3,663,882
自己株式	1,420,923	1,409,594
株主資本合計	6,951,397	7,054,917
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	445,527	410,203
その他の包括利益累計額合計	445,527	410,203
少数株主持分	653,343	644,877
純資産合計	8,050,268	8,109,997
負債純資産合計	9,718,742	10,073,511

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	1,632,533	1,907,345
売上原価	1,174,390	1,279,122
売上総利益	458,142	628,222
販売費及び一般管理費	375,100	420,750
営業利益	83,041	207,471
営業外収益		
受取利息	568	365
受取配当金	32,341	28,795
その他	1,995	2,105
営業外収益合計	34,905	31,266
営業外費用		
為替差損	1	0
支払手数料	-	16
営業外費用合計	1	16
経常利益	117,944	238,721
特別利益		
固定資産売却益	300	-
投資有価証券売却益	27,942	15,123
その他	30	-
特別利益合計	28,272	15,123
特別損失		
固定資産売却損	-	15
特別損失合計	-	15
税金等調整前四半期純利益	146,217	253,828
法人税、住民税及び事業税	22,460	74,766
法人税等調整額	24,164	7,622
法人税等合計	46,625	82,389
少数株主損益調整前四半期純利益	99,591	171,439
少数株主利益又は少数株主損失()	2,664	1,716
四半期純利益	96,927	173,155

(四半期連結包括利益計算書)
 (第 1 四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 6 月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	99,591	171,439
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	213,030	35,324
その他の包括利益合計	213,030	35,324
四半期包括利益	113,439	136,115
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	116,103	137,831
少数株主に係る四半期包括利益	2,664	1,716

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
該当事項はありません。

(4) セグメント情報

前第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	1,182,915	449,617	1,632,533
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-
計	1,182,915	449,617	1,632,533
セグメント利益	146,841	50,351	197,193

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	197,193
セグメント間取引消去	-
全社費用(注)	114,152
四半期連結損益計算書の営業利益	83,041

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	1,328,795	578,550	1,907,345
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-
計	1,328,795	578,550	1,907,345
セグメント利益	220,291	118,683	338,974

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	338,974
セグメント間取引消去	-
全社費用(注)	131,503
四半期連結損益計算書の営業利益	207,471

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

生産実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	606,439	200.5	722,765	19.2
産業用制御機器	193,639	33.4	122,690	36.6
計測機器	109,623	17.6	139,590	27.3
小計	909,702	106.6	985,046	8.3
自社製品				
組込みモジュール	91,962	107.5	111,012	20.7
画像処理モジュール	59,858	92.4	83,195	39.0
計測通信機器	51,691	25.0	72,207	39.7
小計	203,512	74.3	266,414	30.9
合計	1,113,214	99.9	1,251,461	12.4

(注) 1 金額は製造原価にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、商品仕入実績として別途記載しております。

商品仕入実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
自社製品				
自社製品関連商品	28,362	167.8	35,534	25.3
合計	28,362	167.8	35,534	25.3

(注) 1 金額は仕入価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

受注状況及び販売状況

イ) 受注高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	782,440	237.2	842,451	7.7
産業用制御機器	223,626	30.9	227,568	1.8
計測機器	133,195	6.0	206,132	54.8
小計	1,139,262	115.5	1,276,152	12.0
合計	1,139,262	115.5	1,276,152	12.0

ロ) 受注残高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	419,287	347.4	332,501	20.7
産業用制御機器	240,168	56.4	209,439	12.8
計測機器	123,988	16.5	177,314	43.0
小計	783,444	121.5	719,255	8.2
合計	783,444	121.5	719,255	8.2

ハ) 販売実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	829,242	304.6	977,569	17.9
産業用制御機器	210,093	20.7	175,212	16.6
計測機器	143,579	69.8	176,013	22.6
小計	1,182,915	155.2	1,328,795	12.3
自社製品				
組込みモジュール	158,847	151.7	193,016	21.5
画像処理モジュール	139,900	167.6	180,189	28.8
計測通信機器	124,771	35.9	160,879	28.9
自社製品関連商品	26,098	70.2	44,464	70.4
小計	449,617	102.1	578,550	28.7
合計	1,632,533	138.0	1,907,345	16.8

(注) 1 金額は販売価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 受注及び受注残高は受託製品セグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。